

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年11月27日(2008.11.27)

【公開番号】特開2006-173605(P2006-173605A)

【公開日】平成18年6月29日(2006.6.29)

【年通号数】公開・登録公報2006-025

【出願番号】特願2005-353136(P2005-353136)

【国際特許分類】

H 01 L 33/00 (2006.01)

H 01 L 23/12 (2006.01)

【F I】

H 01 L 33/00 N

H 01 L 23/12 Z

【手続補正書】

【提出日】平成20年10月8日(2008.10.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電子デバイスをパッケージングする方法であつて、

前記電子デバイスを基板上の電気接続部へ電気的に接続するステップと、

前記電子デバイスを前記電気接続部に固定する為に固定剤を供給するステップと、

前記電気接続部をパッケージの接続部として露出させる為に前記基板の少なくとも一部分を除去するステップと

を含んでなる方法。

【請求項2】

前記電子デバイスが発光ダイオードであることを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記固定剤が透明であることを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。

【請求項4】

前記基板上に前記電気接続部を形成するステップを更に含み、前記電気接続部が不均一な厚さに形成されるものであることを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項5】

前記電気接続部がリフレクタカップを備えるように形成され、前記電子デバイスを前記リフレクタカップ中に搭載するステップを更に含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。

【請求項6】

前記固定剤が供給される側にある前記電気接続部の面にスロットが設けられることを特徴とする請求項4に記載の方法。

【請求項7】

前記基板が、半導体、ポリマー、プラスチック複合材、及び金属を含むグループから選択された材料からなることを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項8】

前記基板が機械的な処理により少なくとも部分的に除去されることを特徴とする請求項1に記載の方法。

**【請求項 9】**

前記基板が化学的な処理により少なくとも部分的に除去されることを特徴とする請求項1に記載の方法。

**【請求項 10】**

電子デバイスと、

前記電子デバイスに電気的に接続される電気接続部と、

前記電子デバイスを前記電気接続部へ固定する固定剤と

を備えてなり、

前記固定剤が前記電子デバイスのパッケージを提供するものであり、

前記電気接続部が前記固定剤中に埋め込まれ、前記固定剤の一面において露出していることを特徴とする、パッケージングされた電子デバイス。